

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 2 部門第 4 区分  
 【発行日】平成 23 年 3 月 24 日 (2011.3.24)

【公開番号】特開 2009-220405 (P2009-220405A)  
 【公開日】平成 21 年 10 月 1 日 (2009.10.1)  
 【年通号数】公開・登録公報 2009-039  
 【出願番号】特願 2008-67420 (P2008-67420)  
 【国際特許分類】

**B 2 8 D 5/00 (2006.01)**

**B 2 8 D 1/24 (2006.01)**

【F I】

B 2 8 D 5/00 Z

B 2 8 D 1/24

【手続補正書】  
 【提出日】平成 23 年 2 月 3 日 (2011.2.3)  
 【手続補正 1】  
 【補正対象書類名】特許請求の範囲  
 【補正対象項目名】全文  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【特許請求の範囲】  
 【請求項 1】

脆性材料基板上に形成された機能領域を各機能領域毎に分断して製品基板とするためスクライプするスクライプ装置であって、

前記脆性材料基板は、スクライプするライン毎に對のアライメントマークが設定されたものであり、

前記スクライプ装置は、

前記脆性材料基板が設置されるテーブルと、

前記テーブル上の脆性材料基板に對向するように昇降自在に設けられ、その先端にスクライピングホイールを保持するスクライプヘッドと、

前記スクライピングホイールを前記脆性材料基板の表面に押圧した状態で前記スクライプヘッド及び脆性材料基板を相対的に移動させる移動手段と、

前記脆性材料基板のスクライプすべきラインの端部に設けられたアライメントマークを撮影するカメラと、

スクライプするラインを含むレシピデータテーブルをあらかじめ保持し、前記レシピデータテーブルに基づいて前記移動手段により脆性材料基板に設けられている一対のアライメントマークを結ぶラインに一致するように脆性材料基板を相対的に移動させると共に、前記スクライプヘッドを昇降させてスクライプを行うコントローラと、を具備するスクライプ装置。

【請求項 2】

前記スクライプヘッドは、高浸透型のスクライピングホイールを用いた請求項 1 記載のスクライプ装置。

【請求項 3】

脆性材料基板上に形成された機能領域を各機能領域毎に分断して製品基板とするためスクライプを形成するスクライプ方法であって、

前記脆性材料基板は、スクライプするライン毎に對のアライメントマークが設定されたものであり、

スクライプライン毎に前記脆性材料基板に設けられた一対のアライメントマークを検出

し、

前記一対のアライメントマークを通るラインをスクライブするように前記テーブルを移動し、

スクライブヘッドを脆性材料基板上に降下させて、前記アライメントマークを結ぶラインに沿って前記脆性材料基板をスクライブするスクライブ方法。